

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年9月22日 (22.09.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
**WO 2005/088711 A1**

(51)国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 23/36, G02F 1/1345, H05K 1/02

(21)国際出願番号: PCT/JP2005/004349

(22)国際出願日: 2005年3月11日 (11.03.2005)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:  
特願2004-074285 2004年3月16日 (16.03.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 福迫浩幸 (FUKUSAKO, Hiroyuki). 濑野和徳 (SENO, Kazunori).

(74)代理人: 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナーズ (IKEUCHI SATO & PARTNER PATENT ATTORNEYS); 〒5306026 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番30号 OAPタワー26階 Osaka (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

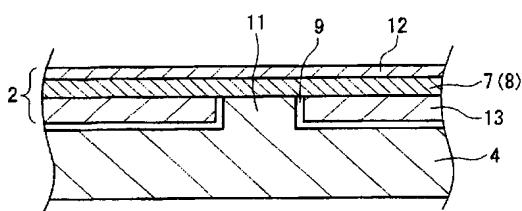
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドノート」を参照。

(54) Title: DRIVER MODULE STRUCTURE

(54)発明の名称: ドライバモジュール構造



(57) Abstract: Disclosed is a driver module structure comprising a flexible substrate (2) provided with a wiring pattern (7), a semiconductor device mounted on the flexible substrate (2), and a conductive heat-dissipating body (4) joined to the semiconductor device. The wiring pattern (7) includes a ground wiring pattern (8), and the flexible substrate (2) is provided with a hole (9) through which a part of the ground wiring pattern (8) is exposed. The exposed ground wiring pattern (8) and the heat-dissipating body (4) are electrically connected through a member (11) fitted in the hole (9).

(57)要約: 配線パターン(7)が形成されたフレキシブル基板(2)と、フレキシブル基板(2)に搭載された半導体装置と、半導体装置に接合された導電性の放熱体(4)とを備えたドライバモジュール構造であって、配線パターン(7)はグランドの配線パターン(8)を含んでおり、フレキシブル基板(2)に、グランドの配線パターン(8)の一部を露出させた孔(9)が形成されており、孔(9)に嵌合した部材(11)を介して、露出したグランドの配線パターン(8)と放熱体(4)とが導通するように接続されている。

WO 2005/088711 A1